

## 2025年度 名古屋大学工学部・工学研究科

### UPWARDS for the Future 半導体サマープログラムへの派遣募集について（通知）

2023年5月に開催された広島サミットにおいて、UPWARDS for the Future（半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ、以下UPWARDS）が創設されました。

UPWARDSはマイクロン財団、マイクロン社及び東京エレクトロン（株）からの資金提供に基づき、日本側5大学（名古屋大学、東北大学、東京工業大学、広島大学、九州大学）と米国側6大学（レンセラー工科大学、ロチェスター工科大学、パデュー大学、ワシントン大学、ボイシー州立大学、バージニア工科大学）が本枠組みに参画し、日米大学間での主に女子学生を中心とした半導体分野の人材育成・人材交流を行うプログラムとなります。

この度、名古屋大学工学部および大学院工学研究科では、米国側UPWARDS参画大学であるバージニア工科大学、ワシントン大学及びロチェスター工科大学が実施する半導体サマープログラムに派遣する学生を下記により募集します。

### 記

1. 応募資格  
名古屋大学工学部，工学研究科に在籍する現学部2年生以上（令和7年度派遣時3年生以上）及び大学院学生で，半導体分野に強い興味・関心があり，将来その分野に関係した進路を考えていること（必須）。また半導体分野の研究に従事している学生，博士前期課程学生，博士後期課程進学を予定している学生（歓迎）。  
なお，UPWARDSの趣旨から，日本国籍保持者のみを対象とする。
2. 派遣対象大学  
① バージニア工科大学（VT）  
② ロチェスター工科大学（RIT）  
③ ワシントン大学（UW）
3. プログラム期間  
① 令和7年7月28日（月）～8月5日（火）  
② 令和7年8月6日（水）～8月16日（土）  
③ 令和7年8月11日（月）～8月15日（金）又は  
令和7年8月18日（月）～8月22日（金）
4. 派遣人数  
①，②，③ それぞれ4名程度（男女各2名程度を想定）
5. 参加費用  
パスポート，ESTA取得費用，海外旅行保険料及びプログラムに含まれない現地食事代・課外活動費用については，参加者負担とする。  
なお，渡航のための航空券代及び半導体プログラム参加費用は大学負担とする。
6. 応募締切  
令和7年4月11日（金）正午
7. 書類提出先  
最先端半導体研究戦略室 ノルジン ドラムジャブ（内線 3168）  
E-mail: [upwards@t.mail.nagoya-u.ac.jp](mailto:upwards@t.mail.nagoya-u.ac.jp)  
電子メール題目を「半導体サマープログラム派遣応募」とし，関連書類を電子メール添付にて提出すること。受領の返信を確認すること。

## 8. 提出書類

- (1) 派遣希望願（所定様式1）
- (2) 志望理由書（所定様式2）
- (3) 英語能力証明書の写し ※取得日は問わない。名古屋大学で受験したTOEFL-ITPも可。
- (4) 学業成績証明書（自身で証明書発行機から印刷）

## 9. 選考結果通知          令和7年5月2日（金）（予定）

## 10. 注            意

- (1) 応募書類を提出する前に、予め指導教員の承認を得ておくこと。
- (2) 応募者多数の場合には、選考結果通知送付に先立ち、面接選考を実施する場合がある。詳細については、該当者に追って通知する。
- (3) 以下に定める英語能力を有すること。基本的な英語コミュニケーションや関連するTechnical Term（専門用語）がわかること、IELTS5.0, TOEIC 600, TOEFL iBT35以上あることが望ましい。
- (4) 帰国後、1か月以内に帰国報告書（様式3）を提出すること。帰国報告会への出席，その他，UPWARDS関係プログラムへの参加を求める場合がある。
- (5) 派遣期間中名古屋大学工学部・工学研究科に在籍していること。ただし、非正規生としての在籍は除く。
- (6) ① バージニア工科大学（VT）② ロチェスター工科大学（RIT）③ ワシントン大学（UW）が実施するプログラムの概要は、別紙を参照すること。
- (7) 工学研究科 大学院入試が令和7年8月19日（火）～21日（木）に予定されている。本派遣への参加に支障がないか、各自が出願時に確認，留意すること。
- (8) 派遣決定の場合，工学研究科で実施するIELTS Speaking&Writing講座の受講を必須とするので留意すること。但し，極めて高い英語能力試験の成績を有する者については受講が免除される場合がある。  
(IELTS Speaking & Writing講座について)  
2025年5月13日（火）～7月22日（火）毎週火曜日18:15～19:45に学内で実施。  
受講費用：無料 ※通常有料だが，UPWARDS参加者については，大学が負担する。  
詳細は，派遣可否と併せて応募者へ通知する。

## UPWARDS Summer Intensive Program 2025 – Information Sheet

Host University	Virginia Polytechnic Institute and State University
Program Title	VT Semiconductors Summer Camp
Program Period (Dates)	July 28-August 5, 2025
Location & Venue	Blacksburg, Virginia, Manassas, Virginia, Arlington, Virginia, and Alexandria, Virginia
Maximum Enrollment from Partner Universities	20
Program Fee	3,500 USD
Requirements	Students from UPWARDS network universities with English proficiency and GPA higher than 3.0
Application Method & Deadline	2025/4/15
Curriculum Overview	<p>Monday, July 28: Arrival Day in Blacksburg, Virginia and Hotel Check-in. Opening Ceremony and VT Main Campus Tour</p> <p>Tuesday-Wednesday, July 29-30: Technical Program on IC Testing and Memory Design. Bus and walking tour of Blue Ridge Mountains.</p> <p>Thursday July 31: Morning session concludes IC Testing and Memory Design program. Afternoon bus and visit to famous Luray Caverns. Continue to Manassas, VA and overnight Hotel.</p> <p>Friday, Aug 1: Tour of Micron Technology in Manassas, Virginia. Then travel to Virginia Tech Innovation Campus in Alexandria, Virginia. Check in to Alexandria hotel.</p> <p>Saturday, Aug 2: Technical program on Electronics Packaging at VT Innovation Campus</p> <p>Sunday, Aug 3: Tour of Washington, DC. Free time.</p> <p>Monday, Aug 4: Technical program on Electronics Packaging continues</p> <p>Tuesday, Aug 5: Morning Closing Ceremony and Departure Day from Dulles Airport</p>
Information about Accommodation	
Contact Information	Professors Luke Lester (lflester@vt.edu) and Jeff Walling (jswalling@vt.edu)
Program Website & Other Information	

## UPWARDS Summer Intensive Program 2025 – Information Sheet

Host University	Rochester Institute of Technology
Program Title	RIT UPWARDS SUMMER PROGRAM
Program Period (Dates)	August 6-16, 2025
Location & Venue	Rochester, NY, USA
Maximum Enrollment from Partner Universities	20
Program Fee	\$3,500 per student
Requirements	Students from UPWARDS network universities with English proficiency and GPA higher than 3.0
Application Method & Deadline	2025/2/28
Curriculum Overview	<p>Wednesday, Aug 6: Arrival Day Pick-up from airport and check-in at RIT Inn</p> <p>Thursday, Aug 7: Orientation Program orientation and lunch, followed by campus tour</p> <p>Friday, Aug 8: GlobalFoundries Company visit to GlobalFoundries, followed by stop at USA Destiny Mall</p> <p>Saturday, Aug 9: Rochester Tour Day Explore around Rochester</p> <p>Sunday, Aug 10: Free Day Free day for students</p> <p>Monday, Aug 11: Training Session Introduction to Semiconductors + Linton Crystal Technologies</p> <p>Tuesday, Aug 12: Training Session Clean Rooms</p> <p>Wednesday, Aug 13: Niagara Falls Niagara Falls + Maid of the Mist, followed by a Red Wings Game in the evening</p> <p>Thursday, Aug 14: Training Session Solar Day!</p> <p>Friday, Aug 15: Training Session + Closing Ceremony Final training session in the morning, followed by the Closing Ceremony</p> <p>Saturday, Aug 16: Departure Day Check-out of RIT Inn and drop off at airport</p>
Information about Accommodation	
Contact Information	Alyssa Brault (anbgbl@rit.edu)
Program Website & Other Information	



RIT

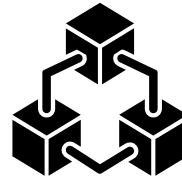
# UPWARDS @RIT

Immersive Learning Program in Rochester, NY

The UPWARDS Program provides students and faculty with a wide array of experience and exposure centered around hands-on-training sessions, technical demonstrations, tours of the Rochester Institute of Technology's cutting-edge facilities and labs, time in clean rooms, seminars, globally recognized company visits, and more.

**Semiconductor development is currently one of the fastest growing industries.** Gain firsthand experience and insight in this highly sought after field at the cutting-edge facilities and labs at the **Rochester Institute of Technology** located in Rochester, New York.

# Program Details



## Program Highlights

**Tentative Dates:** August 6-16, 2025

**Location:** Rochester, New York

**Program Fee Per Participant:** \$3,500 USD

**Limit # of Student Participants:** 20 in total

**To Apply:** Your home university can nominate exchange students to RIT by **Feb. 28<sup>th</sup>** by emailing Alyssa Brault at [anbgbl@rit.edu](mailto:anbgbl@rit.edu). Each university can select up to 4 student participants, together with 5 additional waitlisted students. Program questions can be directed to the above email as well.

## Program Fee Includes:

- Tuition for the eleven-day Certificate Program
- Stay Accommodations (Tentative: August 6-16)
- Program Orientation
- Group Meals and Personal TigerBucks Dining Cards
- Professional Visits and Cultural Excursions
- Transportation for Program Activities
- Transportation to and from the ROC airport

**Please note:** Students should plan on additional costs for daily meals and personal, miscellaneous spending. **Program does not include cost of airfare, health or travel insurance, or visitor visa costs.**

**Immersive,  
hands-on  
experience**

**Connect  
with RIT  
alumni**

**Learn from  
those in the  
industry**

**Company  
tours,  
excursions,  
and more**



## Questions?

## Contact Information

Jing Zhang, Ph.D.  
Associate Professor  
Kate Gleason College of  
Engineering  
[jzeme@rit.edu](mailto:jzeme@rit.edu)

Alyssa Brault,  
Program Administrator  
International  
Education and Global  
Programs  
[anbgbl@rit.edu](mailto:anbgbl@rit.edu)

# UPWARDS Nominee Qualifications

**Please note:** Students for this specialized, immersive learning program will be nominated by their university. The list of students nominated should be presented to the Rochester Institute of Technology by **February 28, 2025**, by emailing Alyssa Brault at [anbgbl@rit.edu](mailto:anbgbl@rit.edu).

Your university can select up to 4 students to participate in this program, as well as provide a waitlist of 5 additional students in the event that more spots become available.

Below are the qualification requirements a student must meet to be considered for this program:

- Must have a GPA of 3 or higher
- Must be in good academic standing
- Must be in compliance with the university's Code of Conduct
- Must have proficient English language skills – with an IELTS score of 5 or higher or a TOEFL iBT score of 35 or higher

- Students must meet the following requirements before being selected for this program.
- Failure to do so will result in an automatic withdrawal from the program.
- For more information or questions, please contact Alyssa Brault at [anbgbl@rit.edu](mailto:anbgbl@rit.edu)

## UPWARDS Summer Intensive Program 2025 – Information Sheet

Host University	University of Washington
Program Title	University of Washington UPWARDS Summer Intensive Program 2025
Program Period (Dates)	Week of Aug. 11-15 or Aug. 18-22
Location & Venue	University of Washington Seattle Campus 1410 NE Campus Pkwy, Seattle, WA 98195 United States of America
Maximum Enrollment from Partner Universities	12
Program Fee	2,500 USD
Requirements	Students currently enrolled in STEM undergraduate and graduate programs at a UPWARDS member universities.
Application Method & Deadline	TBD
Curriculum Overview	<p>The overarching goals of this week-long internship are to provide participants with hands-on experience with semiconductor research at the Washington Nanofabrication Facility (WNF), knowledge of the current landscape of semiconductor research and industry, and an opportunity to explore the Pacific Northwest.</p> <p>On day 1, students will participate in a full day orientation to the internship and the WNF. Students will then spend each morning conducting research at the WNF and each afternoon hearing from guest speakers from the semiconductor field and exploring Seattle and the beautiful Pacific Northwest.</p>
Information about Accommodation	
Contact Information	Application instructions are forthcoming and can be found here: <a href="https://www.upwards.uw.edu/">https://www.upwards.uw.edu/</a> .
Program Website & Other Information	University of Washington will provide housing on or near campus from Saturday - Saturday.



(様式1)

## 派遣希望願

令和7年 4月 日

工学部長・工学研究科長 殿

指導教員 \_\_\_\_\_ 印

所 属 \_\_\_\_\_ 学 科 \_\_\_\_\_ 年  
博 士 課 程 ( \_\_\_\_\_ 課程)  
専 攻 \_\_\_\_\_ 年

氏 名 \_\_\_\_\_

希望する派遣先

第1希望 \_\_\_\_\_ 大学

第2希望 \_\_\_\_\_ 大学

第3希望 \_\_\_\_\_ 大学

(申請者の都合によっては、全てを記入する必要はない。)

英語能力試験スコア

TOEFL iBT \_\_\_\_\_ 点 IELTS \_\_\_\_\_ TOEIC \_\_\_\_\_ 点  
(取得日 \_\_\_\_\_) (取得日 \_\_\_\_\_) (取得日 \_\_\_\_\_)

上記以外の英語スコア \_\_\_\_\_

(名古屋大学で受験したTOEFL ITPを含む)

このたび、令和7年度UPWARDS半導体サマープログラムへの参加を希望しますので、下記の書類を添えて申請いたします。

記

- (1) 派遣希望願 (所定様式1)
- (2) 志望理由書 (所定様式2)
- (3) 英語能力証明書の写し
- (4) 学業成績証明書

(様式2)

## 志 望 理 由 書

氏 名 \_\_\_\_\_

希望する派遣先

第1希望 \_\_\_\_\_ 大学

第2希望 \_\_\_\_\_ 大学

第3希望 \_\_\_\_\_ 大学

(申請者の都合によっては、全てを記入する必要はない。)

本プログラムの志望動機や自身の研究内容、半導体分野への興味・関心、派遣先大学で実施したい内容等について、500～800字程度で記載してください。

(様式3)

帰国報告書（半導体サマープログラム）

年 月 日

工学部長・工学研究科長 殿

所 属 学 科 年  
博 士 課 程 ( 課程)  
専 攻 年

氏 名 \_\_\_\_\_

(1) 派遣先大学，学科・専攻名 ○○○○大学

(2) 派遣期間

年 月 日 ～ 年 月 日

(3) 派遣中の活動概要，感想，派遣で得られた成果など